

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-112

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年12月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年12月14日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事10人，实到10人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属流程于2021年12月14日实施完毕，300万股归属股票于12月16日上市流通，公司股本因此增至279,004,251股，需对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》中有关条款做相应修改。此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过，同时提请股东大会授权董事会及相关责任人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》

根据公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司业务发展及资金情况，

为满足经营发展需求，促进业务持续稳定发展，惠伦晶体（重庆）科技有限公司拟向银团申请人民币 17,000 万元的贷款，授信期限为 4 年。银团由中国银行重庆綦江支行及农业银行重庆江北支行、南川支行组成，其中，中国银行与农业银行各占 50%。本次银团贷款以惠伦晶体（重庆）科技有限公司所有的渝（2020）万盛区不动产权第 000773039 号地块及土地上厂房（取得不动产权证后）、设备提供抵押担保（达抵押条件后），由公司提供连带责任担保（保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年），专用于高基频超小型频率元器件项目二期建设。同时，提请董事会授权董事长或其授权人代表公司签署上述贷款额度内与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，包括但不限于授信、借款、抵押、保证、融资等法律文件。授权期限与银行授信期限一致，在授权期限内，授权额度可以循环使用。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告》及独立董事意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。

以上内容经董事会审议，全体与会人员一致同意。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意定于 2022 年 1 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日